

2024年12月6日

会員各位

車載組込みシステムフォーラム（ASIF）事務局

2024年度第1回ASIF応用技術セミナー開催案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記要領にて車載組込みシステムフォーラム（ASIF）2024年度第1回応用技術セミナーを開催します。参加希望の方は、下の【申込み】欄に記載のWebからお申し込みいただきますようお願い申し上げます。

敬具

【テーマ】 半導体の最前線 チップレット技術がもたらす変革  
半導体製造工場（前工程）の見学

【開催日】 2025年1月16日（木）13:00～16:45（受付開始 13:00～）

【集合場所】 ルネサスエレクトロニクス 那珂工場 正門（受付時間：13:00～13:30）

【セミナー概要】

半導体の新トレンドと言われているチップレット技術の最新動向についてご紹介をさせていただきます。その後、ルネサスエレクトロニクス様の半導体製造工場（前工程）を見学いただきます。

【参加費】 ASIF 会員：無料

ASIF非会員：3,000円（消費税込）

※参加費は、銀行振込（振込期限2025/1/15、振込手数料はご負担ください）

※振込先口座：三菱UFJ銀行柳橋支店 普通預金口座4805255

公益財団法人中部科学技術センター（ASIF）

ヨミ：コウキガ イダシホウジ ノチウブ カク ケジ ヲツセンター アズイ

【定員】45名

【申込み】

・下の各申込フォーム（SECURE FORMサイト）からお申込みください。

<https://www.secure-cloud.jp/sf/1697613801YvgiEGiT>

申込期限：2024年12月26日（木）

迷惑メールフィルタやセキュリティ設定等により、自動返信メール（受付票）が届かない場合がございます。

しばらくお待ちいただいても届かない場合は、おそれいりますが、再度お申込みいただくか、メールで事務局にお問い合わせください。

注意事項：

- ・半導体同業他社、半導体向けテスト装置メーカーの方の申込みはご遠慮ください。
- ・本セミナーは定員が少ないため、確実にご参加いただける方でお申し込みください。
- ・お申し込み状況（同一企業から複数名の申込みがあった等）により、受付後に調整をお願いする場合があります。
- ・駐車場は用意できませんので、公共交通機関でお越しください。
- ・講演、見学時の撮影は禁止となります。

## 【プログラム】

13:00 ルネサスエレクトロニクス 那珂工場 正門

13:25～13:30(5分) 開催ご挨拶

13:30～14:30(60分) 講演1

講演題目：先端チップレットの開発動向とアカデミアの役割

講演者名：横浜国立大学 工学研究院 准教授 井上 史大 様

講演概要：半導体後工程、チップレットに大きな注目が集まっている。我が国は後工程で強みを有するベンダーが多く存在し、近年になり後工程関連の研究開発拠点も多く設立されている。しかし、依然として前工程とのギャップ、また後工程においてもチップ層、インターポーザ、基板の各層でのプレイヤーの違いから、技術や開発状況が正しく理解されていない場合もある。本講演では広くチップレット、後工程について解説し、その後将来を見据えた開発動向の解説し、現在我が国のみならず世界的に広く展開されている後工程の研究開発拠点形成について紹介します。

14:30～15:00(30分) 講演2

講演題目：先端 SoC チップレットの技術動向とルネサスの取り組みについて

講演者名：ルネサスエレクトロニクス株式会社

ハイパフォーマンスコンピューティングプロダクトグループ

HPCマーケティング統括部

技師長 原 博隆 様

講演概要：生成 AI や自動運転の世界で必須となる先端半導体ですが、半導体のプロセスは 2nm の世代に突入しようとしています。プロセスの微細化に伴って、1つの LSI に集積される回路の数も飛躍的に増大してきている一方で、1つの LSI にすべて機能を搭載するのではなく、標準的な機能と Add-on となる機能に分割しようという動きが出てきています。

これを実現する手段の一つがチップレットと呼ばれる技術です。車載向け半導体ベンダーであるルネサスの観点で、この技術について解説します。

15:00～15:10(10分) 休憩

15:10～15:40(30分) 講演3

講演題目：LSI 製造工程の概要

講演者名：ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社

オペレーショングループ 那珂工場 製造第二部

部長 高橋 雅人 様

講演概要：半導体 LSI の製造は大きく前工程と後工程に分かれます。

前工程はウェーハ上に回路を成形する工程、後工程はウェーハからチップを切り出しパッケージに封止する工程になります。

今回は前工程について説明します。

15:40～16:40(30分) 半導体製造工場（前工程）見学

16:40～16:45(5分) 閉会ご挨拶

## 【問合せ先】

車載組込みシステムフォーラム（ASIF）事務局

公益財団法人中部科学技術センター イノベーション創出支援室

TEL : 052-231-6723 FAX : 052-204-1469 e-mail : [monodukuri@cstc.or.jp](mailto:monodukuri@cstc.or.jp)

## 【会場】

ルネサスエレクトロニクス 那珂工場

〒312-8511 茨城県ひたちなか市堀口 751 番地 Tel : 029-272-3111（代表）

最寄り駅：勝田駅

勝田駅から那珂工場までのご案内（勝田駅西口より徒歩 10 分程度）



**当日の緊急連絡先：ASIF 事務局 TEL 080-2642-7211**

## 【参考情報】

### ・品川～勝田へのアクセス

品川 10 : 14 発 ときわ 57 号 → 勝田 11 : 53 着

品川 10 : 45 発 ひたち 9 号 → 勝田 12 : 11 着

品川 11 : 15 発 ときわ 59 号 → 勝田 12 : 50 着

### ・勝田～品川へのアクセス

勝田 17 : 21 発 ひたち 22 号 → 品川 18 : 52 着

勝田 17 : 47 発 ときわ 78 号 → 品川 19 : 21 着

勝田 18 : 21 発 ひたち 24 号 → 品川 19 : 51 着

勝田 18 : 47 発 ときわ 80 号 → 品川 20 : 23 着